

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-17

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（网络和现场会议方式结合）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	山西证券、信达澳亚、宝盈基金、创金合信、九泰基金、泓德基金、创华投资（因采取网络和现场会议方式结合，部分参会者未签署书面调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。）
时间	2024年8月21日 14:00-15:30
地点	广州广合科技股份有限公司会议室
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清 证券事务代表：陈炜亮、黄淑芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2024年上半年经营情况：</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入约170,558.35万元，同比增长45.50%，实现归属于上市公司股东的净利润31,938.71万元，同比增长102.42%。</p> <p>2024年第二季度，公司实现营业收入约92,122.60万元，环比增长17.45%，实现归属于上市公司股东净利润17,430.10万元，环比增长20.14%。</p> <p>2024年上半年，公司积极应对全球供应链调整、汇</p>

率波动、原材料价格波动等外部环境带来的挑战，坚持以技术创新、产品迭代驱动公司发展，持续加大技术研发和创新投入，提高产品的附加值和竞争力，取得丰硕的成果。同时，受上半年行业订单需求回暖影响，公司紧跟市场需求，积极开拓业务，各厂产能利用率均有提升，实现业绩稳定增长。

2024 年上半年，公司 EGS 平台服务器产品出货占比继续提升，BHS 和 Turin 平台以及交换机产品完成小批量出货，同时公司启动了 Oak 平台和 Venice 平台样品的试制。全面参与客户 UBB、I/O 等 AI 产品的量产项目，报告期内公司加大了 PCIe 交换板和 OAM 板的开发力度，进一步提升高端产品占比。在产能建设方面，公司积极推动广州一厂 HDI 能力提升，以应对当前的 BMC 及加速卡的需求。同时为加大海外市场开拓力度，满足海外客户全球供应链调整的需求，公司泰国生产基地建设按计划快速推进，预计明年一季度实现规模量产。

报告期内，公司把握行业结构性机会，继续加大业务拓展力度，产能稼动率保持在良好水平，同时伴随 AI 加速演进及应用上的不断深化，以及通用服务器迭代升级，拉动公司产品结构持续优化，公司 2024 上半年的营收和净利润较上年同期均有所增长。公司所处行业需求稳定，经营业绩稳步提升。

二、行业及服务器市场业务情况：

进入 2024 年，PCB 需求有所好转，行业修复明显，

主要得益于 AI 及汽车电子领域需求保持高位，同时下游消费电子等领域需求亦有改善。

从中长期看，AI 推动的下游需求增长将继续拉升高频高速板、HDI 板、IC 载板等高端 PCB 需求，成为 PCB 增长的主要动力。预计封装基板、HDI 板、18 层及以上的高多层板等高端产品仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为 8.80%、7.10%、10.00%。

公司着力深耕于高速 PCB 领域的研究，形成了以服务器 PCB 业务为主，消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域 PCB 为辅的业务结构。未来公司仍将聚焦服务器 PCB 主航道，围绕企业所制定的“云、管、端”发展战略，重点对 PCIe6.0 服务器、AI 服务器、新一代路由交换机、6G 基站、5.5G 低轨通讯、AI 电脑、自动驾驶、高清显示、新能源等领域组织技术研发和产品开发。在巩固服务器用 PCB 市场地位的同时，也积极拓展通信设备以及智能终端设备的 PCB 产品市场。通过完善产品结构，优化技术能力布局，提高市场竞争力和盈利能力。

在产能建设方面，公司积极推动广州一厂 HDI 能力提升，以应对当前的 BMC 及加速卡的需求。

三、公司泰国基地进展情况：

为加大海外市场开拓力度，满足海外客户全球供应链调整的需求，在泰国投资建设工厂，设计满产年销售约 20 亿元。公司泰国生产基地建设按计划快速推进，预计明年一季度实现规模量产。

四、公司泰国工厂产品定位：

主要产品定位新一代服务器及交换机产品，以公司目前量产的 PCIe5.0 服务器产品定位为起点，并且规划保留了后续升级的空间，泰国工厂将对接服务海外客户，在数据中心、通讯领域与广州工厂形成协同。

五、公司 2024 年上半年技术研发成果：

NPI 制造能力：形成板厚 5.7mm，钻刀 0.2mm 的钻孔、电镀、除胶等能力，推动 800G 光模块，800G 交换机、AI 7 阶 HDI 的样品制作，完成 4 阶 BMC 的 NPI 制作，实现 M8 级材料的量产加工能力；

在材料研究方面：已经覆盖高速 SULL (M8 级材料量产，M9 级材料预研)。

六、公司广州工厂二季度稼动率的情况：

广州工厂通过持续对关键工序进行技术改造，以达到提升工艺能力和瓶颈工序产能的目标，就二季度的稼动率持续保持在较高的水平。

七、公司股权激励方面的规划：

公司在上市之前对核心管理技术人员做过一轮股权激励，这些年公司业务快速发展，每年不断有新的管理、技术人才加入到企业，公司将企业的长远发展和员工的个人利益形成更加紧密的关系，也乐于让关键管理、技

	<p>术岗位员工分享企业的成长与发展。股权激励作为一种长期且富有吸引力的激励机制有助于公司吸引和留住优秀的人才，公司正积极的推动相关准备工作。</p> <p>八、公司 HDI 相关产品及布局情况：</p> <p>HDI 采取高密度互连、微盲埋孔技术工艺，在新一代 AI 服务器中应用越来越广泛，针对高阶 HDI 产能公司正积极进行规划布局，提升工艺能力和产能满足下游客户需求。目前应用到 HDI 工艺的主要有：BMC、OAM、switch、光模块、存储等产品。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 21 日